《晶朋科技（张家港）有限公司航空和芯片用超高纯铪材项目环境影响报告书》

删除不宜公开信息内容的说明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》等要求，我公司将于近期全文公示《晶朋科技（张家港）有限公司航空和芯片用超高纯铪材项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）。因环评报告中涉及商业秘密等内容，全文公示的同时删除其中涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私、国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定等内容，具体包括“原料来源及入厂筛选要求、工艺流程及产污环节分析、物料平衡、元素平衡及水平衡、环境质量现状监测数据”等。

特此说明！

建设单位：晶朋科技（张家港）有限公司

2025 年 11 月 24 日